

## 平成24年3月期 業績予想説明資料

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. 平成24年3月期業績予想          | …… P. 1 |
| 2. 報告セグメント別業績推移          | …… P. 2 |
| 3. 減価償却費、資本的支出、研究開発費(連結) | …… P. 3 |

平成23年6月7日

 **日立電線株式会社**

お問合せ先 ビジネスサポート本部人事総務部門総務部広報グループ

TEL 03-6381-1050

FAX 03-5256-3240

# 1. 平成24年3月期業績予想

[単位: 億円(億円未満四捨五入)]

	(A) 平成23年3月期 (平22.4.1~平23.3.31)	(B) 平成24年3月期 (平23.4.1~平24.3.31)	(B/A) 増減率	(B-A) 増減
売上高	4,193	4,450	106%	+257
営業利益	8	70	約8.9倍	+62
営業外損益	△26	△10	—	+16
経常利益	△18	60	—	+78
特別損益	△107	△30	—	+77
税金等調整前当期純利益	△124	30	—	+154
法人税等	2	15	—	+13
少数株主利益	3	5	—	+2
当期純利益	△130	10	—	+140

※平成24年3月期業績予想の前提 為替:80円/\$、銅価:800千円/t

## 対前年同期比 増減要因

### (1) 売上高増減要因について

・銅価変動による影響	+133
・海外会社の決算期統一による影響	+194
・純増減分	△70
合計	+257

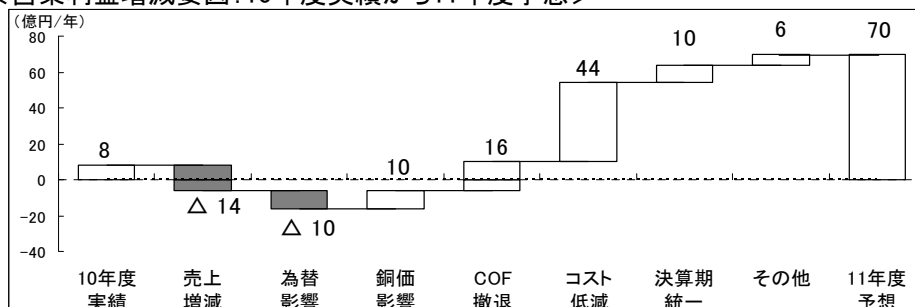
### (2) 営業利益増減要因について

・売上高増減による利益増減	△14
・為替による影響	△10
・銅価変動による影響	+10
・COF事業撤退による影響	+16
・原価低減及び固定費削減	+44
・海外会社決算期統一による影響	+10
・その他	+6
合計	+62

### (3) 経常利益増減要因について

・(2)営業利益の増減要因	+62
・持分法投資損益	+18
・その他	△2
合計	+78

< 営業利益増減要因: 10年度実績から11年度予想 >



## 2. 報告セグメント別業績推移

中期経営計画「プラン“BRIDGE”」のさらなる推進に向けて社内体制の再編を行い、事業の機動性向上のため電機・産業システム事業本部を、産業インフラ事業本部と電機・自動車部品事業本部に分割しました。また、製品や事業の特性を考慮して半導体材料事業本部を分割し、化合物半導体を情報デバイス事業本部に、TABを金属材料事業本部に組み込んでおります。

当社グループでは、平成23年3月期より、マネジメント・アプローチに基づいたセグメント情報の開示をおこなっており、このたびの社内体制の再編に伴い、報告セグメントにつきましても「産業インフラ」「電機・自動車部品」「情報デバイス」「金属材料」「販売会社」の5つのセグメントに改めております。

### (1) 報告セグメント別売上高(外部顧客に対する売上高)

[単位: 億円(億円未満四捨五入)]

	平成23年3月期			平成24年3月期【予想】			増 減			旧報告セグメントによる区分
	上期 累計 (A)	下期 累計 (B)	年度 累計 (C)	上期 累計 (D)	下期 累計 (E)	年度 累計 (F)	11上-10上 (D)-(A)	11下-10下 (E)-(B)	11年度-10年度 (F)-(C)	
産業システム・電力エネルギー	341	379	720	350	375	725	+ 9	△ 4	+ 5	産業用・電力用ケーブル 自動車用部品 光・通信ケーブル 機器用電線・配線部品 巻線 電機・産業システム事業 情報ネットワーク ワイヤレスシステム 情報システム事業 化合物半導体 TAB 半導体材料事業 伸銅品 リードフレーム 金属材料事業 販売会社
光通信	65	76	141	70	85	155	+ 5	+ 9	+ 14	
産業インフラ事業	406	455	861	420	460	880	+ 14	+ 5	+ 19	
自動車部品	177	174	351	155	215	370	△ 22	+ 41	+ 19	
電子材料	243	226	469	220	310	530	△ 23	+ 84	+ 61	
巻線製線	328	328	655	335	475	810	+ 7	+ 147	+ 155	
電機・自動車部品事業	748	727	1,475	710	1,000	1,710	△ 38	+ 273	+ 235	
情報ネットワーク	109	136	245	110	170	280	+ 1	+ 34	+ 35	
ワイヤレスシステム	79	77	157	60	80	140	△ 19	+ 3	△ 17	
化合物半導体	66	58	125	60	70	130	△ 6	+ 12	+ 5	
情報デバイス事業	255	271	526	230	320	550	△ 25	+ 49	+ 24	
銅条	161	156	317	185	190	375	+ 24	+ 34	+ 58	
伸銅	187	204	391	180	175	355	△ 7	△ 29	△ 36	
リードフレーム	68	59	127	65	75	140	△ 3	+ 16	+ 13	
パッケージ材料	87	50	137	50	50	100	△ 37	+ 0	△ 37	
金属材料事業	503	469	972	480	490	970	△ 23	+ 21	△ 2	
販売会社	164	194	358	160	180	340	△ 4	△ 14	△ 18	
販売会社	164	194	358	160	180	340	△ 4	△ 14	△ 18	
計	2,076	2,117	4,193	2,000	2,450	4,450	△ 76	+ 333	+ 257	

### (2) 報告セグメント別営業利益

	平成23年3月期			平成24年3月期【予想】			増 減		
	上期 累計 (A)	下期 累計 (B)	年度 累計 (C)	上期 累計 (D)	下期 累計 (E)	年度 累計 (F)	11上-10上 (D)-(A)	11下-10下 (E)-(B)	11年度-10年度 (F)-(C)
産業インフラ事業	△ 3	△ 7	△ 10	4	12	16	+ 7	+ 19	+ 26
電機・自動車部品事業	14	16	30	3	34	37	- 11	+ 18	+ 7
情報デバイス事業	1	7	8	△ 11	25	14	- 12	+ 18	+ 6
金属材料事業	△ 4	△ 28	△ 32	0	3	3	+ 4	+ 31	+ 35
販売会社	7	11	18	6	14	20	- 1	+ 3	+ 2
調整額	4	△ 10	△ 6	△ 7	△ 13	△ 20	- 11	- 3	- 14
連結全社合計	19	△ 11	8	△ 5	75	70	- 24	+ 86	+ 62

注1: 平成23年3月期の報告セグメント別の売上高、営業利益については、会計士によるレビュー手続きは行っておりません。

注2: 単位未満を四捨五入しているため、個々の項目の合算と合計が合わない箇所があります。

### 3. 減価償却費、資本的支出、研究開発費(連結)

[単位:百万円]

	平成23年 3月期			平成24年 3月期
	上期	下期	年度累計	年度累計 【予想】
産業インフラ事業	843	842	1,685	2,600
電機・自動車部品事業	1,868	1,450	3,318	8,200
情報デバイス事業	1,252	1,096	2,348	2,800
金属材料事業	1,423	1,309	2,732	2,200
販売会社	46	24	70	0
<b>有形固定資産及び 無形固定資産の増加額合計 (資本的支出)</b>	<b>5,432</b>	<b>4,721</b>	<b>10,153</b>	<b>15,800</b>
産業インフラ事業	1,682	1,693	3,375	3,300
電機・自動車部品事業	2,712	2,829	5,541	6,100
情報デバイス事業	1,945	2,072	4,017	4,000
金属材料事業	3,421	3,647	7,068	5,100
販売会社	69	78	147	200
<b>減価償却費合計</b>	<b>9,829</b>	<b>10,319</b>	<b>20,148</b>	<b>18,700</b>
<b>研究開発費</b>	<b>4,840</b>	<b>4,194</b>	<b>9,034</b>	<b>10,000</b>
売上高研究開発費比率	2.3%	2.0%	2.2%	2.2%